

证券代码：688603

证券简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司投资者关系活动

记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参会单位	华创电子、天风电子、浙商电子、国盛电子、中信新材料、国投电子、长城电子、长江电子、方正电子、上海证券、中银基金、圆石投资、全天候私募、兴银基金、富安达基金、国华兴益保险、鸿途私募、新华资产、上海常春藤资管、汇添富基金、银华基金、金广资产、珺容投资、彤源投资、正圆投资、悦溪私募、西部利得基金、古曲私募、驭秉投资、仙人掌资管、东北证券、中信期货、财通证券、宽源私募、平安基金、星火私募、兆顺私募、玖鹏资管、榕树投资、首创证券、长盛基金、歌汝私募、平安资管、汉泽私募、前海德毅、安华农业保险、广发基金、博时基金、睿远基金、东方资管、中信建投、东吴基金、中金资管、中信资管、泓德基金、清和泉资管、磐稳投资、spectrum-capital、鹏聚私募、晨曦投资、东方马拉松资管、紫新瑞投资、上银理财、融通基金、新传奇私募、新华基金、太平资管、中山证券、太平基金、申万菱信基金、米利都投资、宏利基金、方正富邦基金、贤盛投资、兴华基金、中国人寿资管、恒生前海基金、中金公司、肇万资管、易方达基金、源乐晟基金、optimas capital、伊诺尔集团、北大方正人寿资管、汇丰晋信基金、华安财保资管、陆家嘴信托、弘尚投资、天弘基金、正卿私募、国联资管、博道基金、创富兆业、国信证券、玺笠资管、长城基金、长信基金、东证融汇资管、信弘天禾投资、日胜隆资管、沣沛投资、泰康资管、领益智造、孝庸私募、敦和资管、华商基金、南方基金、红筹投资、杭银理财、鑫元基金、长

	江养老保险、鹏华基金、破冰投资、坤溪私募、英大保险、中信保诚基金等共计约 150 位参会人
时间	2026 年 1 月 15 日 (周四) 21:00-22:00
会议地点	进门财经线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：费维 首席技术官、半导体事业部负责人：韩佐晏 证券事务代表：邹榕骏
投资者关系活动主要内容记录	<p>天承科技半导体事业部发展情况更新交流</p> <p>一、开场介绍</p> <p>2024 年 10 月，天承科技在上海金山生产基地举办了一场小规模的线下交流会，CTO 韩佐晏从半导体电镀液全球的市场格局，产品发展趋势，到天承科技具备的产品优势，再到我们怎么去做好这一件事，全面阐述了天承半导体事业部的发展逻辑，也提出了争取 3 年做到国内第一市占率，国内第一品牌这样的目标。</p> <p>时隔一年，我们有了不错的进展，也更有信心去实现当年定下的目标。同时，我们对国内的产业环境有了更清晰的认知和洞察。因此，我跟韩博士借今天这个机会来跟大家分享更新下近况并展望未来。</p> <p>首先，回顾下韩博的履历和背景，韩博士是北大化学本科、港中文化学博士毕业，后在陶氏杜邦一直从事电镀液添加剂方面的研究，来天承科技之前，是华为 2012 实验室电子电镀团队的负责人，负责半导体电镀液添加剂的整体战略规划和产品开发，在解决国内半导体电镀液添加剂“卡脖子”问题上贡献颇多。</p> <p>同时，韩博团队的加入，我认为我们有如下几点值得重点去关注。</p> <p>1、针对天承科技在添加剂的整体研发方面，韩博团队的加入，带来了更大的实力提升。目前研发体系按平台研发、产品研发、应用开发三层次构建。平台研发根据未来应用场景的需求和材料的不断迭代，从头设计添加剂分子，还辅以利用 ai 手段加速研发，是天承科技在未来始终能保持该领域领军企业实力的坚实基础。</p>

2、针对半导体事业部的发展方面，我们当前聚焦在电镀液添加剂产品领域，针对半导体电镀液添加剂做了未来3-5年的发展规划。现已实现产品品类的全面覆盖。团队具备电镀液添加剂从“0到1”的自主创新能力，核心技术已实现自主可控。

3、针对新型产品的应用领域方面，比如介于PCB和半导体之间的产品，天承科技发掘在这块国内的独有优势，针对MicroLED显示、板级封装PLP、玻璃基板TGV等领域正在积极布局并配合国内头部企业加速量产进程，部分产品处于国际领先水平。新型领域相关产品未来带来的营收增量也很可观。

二、问答环节

（一）请问公司半导体事业部业务的具体进展如何，后续如何推进发展。

答复：

自2024年三季度以来，公司已组建具备国内顶尖水平的研发与技术团队，围绕先进制程、先进封装（2.5D/3D）及玻璃基板等重点方向，开展自主研发并持续完善全系列产品布局，现已实现产品品类的全面覆盖。团队具备电镀液添加剂从“0到1”的自主创新能力，核心技术已实现自主可控。

目前，公司产品涵盖应用于Damascene、TSV、RDL、Bumping、TGV等关键工艺的电镀液添加剂，可广泛应用于包括HBM在内的先进封装领域，满足逻辑芯片、存储芯片等各类集成电路在金属互连方面的工艺与材料需求。

2025年，我们通过与上海市半导体产业国资“爱浦迈科技”成立合资公司（“天承智元”）的方式，逐步推进半导体事业部的发展，也取得了数百万的营收，“天承智元”已落户上海市集成电路装备零部件小镇金桥金谷。此外，我们还与上海国投先导基金、国泰海通、上海华谊集团等合作，参与上海市针对电子化学品专项设立的并购基金“电子材料基金”，加速融入上海市的集成电路产业圈。后续，“天承智元”也拟引入各类集成电路产业巨头加速半导体事业部的发展，在

营收上从百万级上升到千万级、亿级的水平，实现我们规划的目标。

（二）贵司半导体电镀液添加业务销售的策略是怎么样的。

答复：

天承科技于 2025 年初组建了半导体销售团队，基于过往公司 PCB 团队的基础和基因，我们半导体这块的销售渠道在摸索中前进。2025 年，通过团队一年的努力，也实现了数百万的销售，开了个好头。

当前，半导体产品的销售策略是，在中小客户中，我们利用销售团队的推广，不断在行业内提高自身的产品知名度，逐步渗透；在大客户、核心客户关系的获取和推进中，我们充分利用跟国内产业巨头的合作，如设备商等，去打通相关环节，也打响公司品牌的知名度。在半导体电镀液添加剂方面，我们的目标是成为国内的 Baseline。

（三）目前两长等头部存储厂所使用我们的相关技术和产品主要是哪些。

答复：

存储厂的应用场景主要包括大马士革工艺、HBM 堆叠中纵向连接所使用的硅通孔 TSV 填孔，以及下一代混合键合技术。其中大马士革电镀液和硅通孔 TSV 填孔电镀液是相对成熟产品，已陆续和客户进行技术交流和多轮的测试打样。混合键合方面，公司自主研发的具有特殊结构的电镀铜添加剂可以降低键合温度和压力，有机会为下一代的混合键合提供全新的解决方案。

（四）当前该半导体电镀液的市场格局以及天承的发展目标是什么。

答复：

当前，全球半导体电镀液的市场超过 10 亿美金，国内目前约 30% 的市场份额，且在不断提升中。天承科技的发展目标是获得国内 20% 以上的市场份额，成为国内领军品牌甚至走向海外。

	<p>(五) 天承科技在市场上最主要的竞品公司包括哪些。</p> <p>答复：</p> <p>天承科技在 PCB 领域是国内的领军品牌，对标杜邦、安美特等国际品牌。在半导体电镀液添加剂领域，公司贯彻的是一如既往的发展逻辑。</p> <p>当前，公司已成为国内少数能够对标并有效替代美国英特格、摩西湖、杜邦、乐思化学、日本石原及德国巴斯夫等国际厂商相关产品的企业之一。未来，公司力争在 3 年内发展为该细分领域的国内领军品牌，并在 TGV 等技术方向实现重要突破与行业领先。</p>
	<p>(六) 玻璃基板这块对应的 TGV 镀铜填孔技术我们做的如何。</p> <p>答复：</p> <p>天承科技在玻璃基板通孔 TGV 金属化提供创新解决方案，在 AR=10~15 的 TGV 填孔电镀加工效率和良率等关键指标超越某国际品牌，实现弯道超车。</p> <p>英特尔此前的目标是 2026 年开始量产该玻璃基板技术，我们也与国内最主流的头部客户持续合作并取得了小批量的订单，当前我们是京东方、三叠纪、玻芯成等 TGV 客户的核心供应商，也在积极配合其未来的量产计划。</p>
	<p>(七) 公司半导体电镀液添加剂的销售模式和毛利率水平如何。</p> <p>答复：</p> <p>不同于 PCB 类产品，半导体电镀液添加剂的产品都是按单价出售，基于公司核心的产品力和对国外产品的替代能力，该类产品的毛利率水平明显高于其他应用领域。公司将持续投入研发，保持在该领域的核心竞争力，以获得在相关产品上的持续不断的获利能力，实现良性循环。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 19 日